

# 部品実装サービス仕様書



運営：株式会社東和テック

\*記載内容は予告なく変更することがあります  
予めご了承ください

## 1. 適用範囲

本基準書は株式会社東和テックによって運営されるプリント基板センターPBにて販売するプリント基板 部品実装サービスに適用する。

## 2. 製造仕様概要

プリント基板センターPBにて提供する部品実装サービスに対する共通仕様

実装方法	実装条件	基板外形	メタルマスク
手半田実装	<ul style="list-style-type: none"><li>・チップ抵抗・コンデンサ 1005 サイズまで</li><li>・QFP は 0.4mm ピッチまで</li><li>・BGA・CSP・LGA・QFN は 手付け実装不可</li><li>・一案件の総点数が 5,000 点以上、一枚の点数が 400 点以上の場合、不可</li><li>・コネクタや IC が多い案件や枚数が多いなどの場合でも不可となる場合があります</li></ul>	10×10mm 以上	不要
手載せ実装	<ul style="list-style-type: none"><li>・BGA のボールサイズ 0.3mm、ピッチ 0.5mm まで</li><li>・一案件の総点数が 7,500 点以上は不可</li></ul>	10×10mm 以上	必要
マウンタ実装	マウンター実装は、 50×50mm 以上の基板寸法で対応 50×50mm 以下の基板寸法の場合は上下 10mm の捨て基板と認識マークを設置する面付けをして大きくして下さい	10×10mm 以上 400×300mm まで	必要

## ■必要となるデータ

実装方法	部品リスト	実装図	メタルマスク用 ガーバーデータ	マウントデータ (部品座標データ)
手半田実装	○	○	×	×
手載せ実装	○	○	○	×
マウンタ実装	○	○	○	○

### 3. メタルマスク製造について

弊社で製作させて頂く場合、一般標準サイズ 650×550mm、データに応じた推奨メタル厚（標準：0.12mm）とさせていただきます。

なお、弊社で製作させて頂いたメタルマスクは、弊社で保管させていただきます。

### 4. ご注文上の注意事項

- ① SMT（表面実装部品）が無く、DIP 品のみの場合は、「手半田実装」でご注文下さい。
- ② 実装進行途中での、部品不足による未実装があった場合には、ご請求金額からその分のお値引きは致しませんので、予めご了承をお願い致します。
- ③ 同じ基板で、異なる部品を実装する場合は、部品リストを分けてご登録ください。
- ④ 以下の場合は、別途お見積させていただきます。  
予めご了承をお願い致します。
  1. 全て DIP 若しくはごく一部がチップ部品で DIP 層での半田付けが可能な基板
  2. DIP 部品は 50 ピンコネクタまでを想定していますのでそれ以上の部品が有る場合
  3. 手半田実装で 50 ピン以上の QFP、コネクタ等有る場合
  4. 異種面付け基板の場合
  5. 洗浄が必要な基板

## 5. 支給実装部品について

### ■チップ品

原則、リール提供可能な部品はリールもしくはカットリールでのご提供をお願い致します。

余った部品は、実装基板と共にご返却させていただきます。

### ■DIP品

バラ支給で問題ございません。

ただしリード部品は足が曲がってしまう可能性がありますので、リールをカットした状態や、トレイに乗った状態をお願い致します。

### ■部品支給について共通事項

原則、部品は、部品ごとに袋に入れ、その袋にリファレンス(部品の番地)と入っている部品個数の記載をお願い致します。

なお、リール品については、袋への梱包は省略で構いません。

また、ご注文時に送付頂いております部品表と実装図について、印刷の上、同梱で送付をお願い致します。

